

반도체 웨트 공정 식각 및 기판 핸들링을 위한 맞춤형 정사각형 PTFE 실리콘 웨이퍼 세정 플라워 바스켓

품목 번호: PL-CP88



소개

실리콘 웨이퍼 가공을 위해 설계된 고순도 PTFE 정사각형 세정 플라워 바스켓. 이 부식 방지 랙은 반도체 제조에서 안전한 웨트 식각 및 기판 핸들링을 보장합니다. 특정 실험실 또는 산업용 웨트 벤치 요구 사항을 충족하기 위해 완전히 맞춤화 가능한 치수와 구성이 제공됩니다.

자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
반도체 제조	오염물질을 제거하기 위해 실리콘 웨이퍼를 RCA 세정 또는 피라냐 식각 용액에 침지.	금속 오염 위험 제로
태양광 전지 생산	텍스처링 및 산 폴리싱 단계 동안 대형 태양광 웨이퍼 핸들링.	대량 처리량 및 내구성
MEMS 장치 처리	다양한 웨트 벤치를 통해 정밀한 마이크로 전자 기계 기판의 안전한 운반.	정밀한 기판 위치 지정
LCD/OLED 유리 세정	박막 증착 전 전도성 유리 기판(ITO/FTO)의 세정.	유리 세정제에 대한 내화학성
고순도 실험실 연구	미량 분석 및 공격적인 화학 소화 공정 동안 시료 보관.	부식성 매체에 대한 우수한 내성
나노기술 기판	연구 환경에서 실리콘 온 인슐레이터(SOI) 또는 사파이어 웨이퍼 처리.	취성 소재의 부드러운 핸들링

사양 범주	PL-CP88에 대한 매개변수 세부 정보
모델 식별자	PL-CP88
주요 소재	고순도 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE)
표준 치수	249mm x 249mm (맞춤형 크기 요청 시 제공 가능)
형상	정사각형 프레임 플라워 바스켓 설계
맞춤화 옵션	슬롯 수량, 슬롯 너비, 슬롯 깊이, 피치 및 핸들 스타일
작동 온도 범위	-200°C ~ +260°C
내화학성	보편적 (용융 알칼리 금속 및 고압 불소 제외)
제작 방법	높은 공차 사양을 위한 종단 간 정밀 CNC 가공
표면 마감	매끄럽고 비다공성 불소수지 마감
호환성	수동 침지 베스 및 자동화 로봇 웨트 벤치 암